



## Comunicato stampa

### **KIOXIA presenta un fattore di forma di nuova generazione per le unità SSD NVMe™ per i server aziendali e i centri dati su cloud**

*Il fattore di forma EDSFF<sup>[1]</sup> E3.S (Enterprise and Data Center SSD Form Factor) consente di ottenere densità e prestazioni superiori, migliorando la scalabilità dei centri dati*



L'immagine mostra le unità SSD montate su un prototipo di server rack con formato 2U che installa un massimo di 48 unità del prototipo del fornitore del server principale. Con la combinazione del modello di valutazione E3.S e del modello di valutazione 2U montato su rack, KIOXIA ha effettuato valutazioni del dispositivo di riferimento con i produttori dei server, come la stima delle prestazioni di sistema, la verifica della dissipazione termica, ecc.

**Düsseldorf, Germania, 30 Giugno 2020** – KIOXIA Europe GmbH ha sviluppato e iniziato la consegna dei campioni di preproduzione di unità SSD nel fattore di forma EDSFF (Enterprise & Datacenter SSD Form Factor) E3.S di prossima generazione, che è in fase di standardizzazione da parte del gruppo di lavoro tecnico della SNIA SFF TA.

E3.S è un nuovo fattore di forma standard per le unità SSD NVMe™ dei server aziendali e dei centri dati su cloud, rivolto in modo particolare alle interfacce PCIe® 5.0 e successive. Il formato E3.S contribuirà alla progettazione e allo sviluppo di sistemi di nuova generazione, come i server su cloud, iperconvergenti, per uso generale e i sistemi AFA (All-Flash Array) nei server aziendali e nei centri dati su cloud.

Le specifiche E3.S consentono di adottare più opzioni di dimensioni, potenza e capacità, il tutto con un connettore comune. Concepito per le future generazioni dell'interfaccia PCIe che offrono rendimenti energetici più elevati, il formato EDSFF E3.S offre prestazioni, efficienza di raffreddamento e flessibilità migliorate rispetto ad altri fattori di forma.

I campioni di preproduzione dei prodotti in formato E3.S di KIOXIA, basati sulle unità SSD PCIe 4.0 NVMe 1.4 della serie CM6 di KIOXIA in un fattore di forma da 2,5 pollici, hanno mostrato prestazioni superiori di circa il 35% con lo stesso controllore e la stessa memoria flash BiCS FLASH™ 3D TLC nel fattore di forma EDSFF E3.S con 4 canali e 28W (-40%) di potenza.

I vantaggi del fattore di forma EDSFF E3.S includono:

- Maggiore densità di memoria flash per un utilizzo più efficiente dell'alimentazione, del fattore di forma della memoria e delle installazioni su sistemi rack
- Supporto all'interfaccia PCIe 5.0 e successive grazie a una migliore integrità del segnale
- Migliori caratteristiche termiche e di raffreddamento
- Prestazioni e vantaggi al di là della versione in fattore di forma da 2,5 pollici
- Indicatori LED per mostrare lo stato dell'unità
- Supporta le configurazioni a 8 canali PCIe

#### Note

[1] I promotori del Gruppo di Lavoro EDSFF includono i fornitori di sistemi server aziendali e di servizi cloud come Dell EMC, Facebook, HPE, Lenovo e altri. KIOXIA partecipa come collaboratore del gruppo di lavoro.

\* NVMe è un marchio di NVM Express, Inc.

\* PCIe è un marchio registrato del PCI-SIG.

\* I nomi di società, le denominazioni di prodotto e le designazioni dei servizi citati in questo documento potrebbero essere marchi delle rispettive aziende.

\* Le informazioni nel presente documento, inclusi i prezzi dei prodotti e le specifiche, il contenuto dei servizi e le informazioni di contatto, sono attuali e sono ritenute accurate alla data dell'annuncio, ma sono soggette a modifiche senza preavviso.

###

#### **Informazioni su KIOXIA Europe**

KIOXIA Europe GmbH (in precedenza Toshiba Memory Europe GmbH) è la filiale con sede Europea di KIOXIA Corporation, uno dei principali fornitori a livello mondiale di memorie flash e unità a stato solido (SSD). Dall'invenzione della memoria flash all'odierna tecnologia rivoluzionaria 3D BiCS FLASH™, KIOXIA continua ad essere pioniere nelle soluzioni di memoria e nei servizi all'avanguardia che arricchiscono la vita delle persone e ampliano gli orizzonti della società. La tecnologia innovativa di memoria flash 3D di della società, BiCS FLASH™, sta plasmando il futuro dello storage in applicazioni ad alta densità, che includono gli smartphone avanzati, i PC, le unità SSD, le autovetture e i data center.

Visitate il nostro [sito web KIOXIA](#)

#### **Contatti per la pubblicazione:**

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germania

Tel: +49 (0)211 368 77-0

Email: [KIE-support@kioxia.com](mailto:KIE-support@kioxia.com)

#### **Contatti per richieste editoriali:**

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 382

Email: [lena1.hoffmann@kioxia.com](mailto:lena1.hoffmann@kioxia.com)

#### **Emesso da:**

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0)1582 390980

Email: [birgit.schoeniger@publitek.com](mailto:birgit.schoeniger@publitek.com)

Web: [www.publitek.com.com](http://www.publitek.com.com)

Rif. KIE\_SSD017/IT\_EMEA